OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

BERGQUIST GAP FILLER TGF 2000

BERGQUIST GAP FILLER TGF 2000
BERGQUIST GAP FILLER TGF 2000, Thermally Conductive, High Performance, Liquid, Gap Filling Material



- Lämmönjohtavuus: 2.0 W/m-K
- Erittäin sopeutuva, suunniteltu herkille ja vähärasitteisille sovelluksille
- Kovettuu huoneenlämmössä nopeutetulla aikataululla
- 100 % kiinteä aine - ei kovettuvia sivutuotteita
- Erinomainen mekaaninen ja kemiallinen vakaus alhaisissa ja korkeissa lämpötiloissa

TUOTEKUVAUS

BERGQUIST® GAP FILLER TGF 2000 on korkean suorituskyvyn lämmönjohtava nestemäinen tilaa täyttävä aine, joka toimitetaan kaksikomponenttisena järjestelmänä ja kovettuu huoneenlämmössä tai kohotetuissa lämpötiloissa. Materiaali tarjoaa tasapainon kovetetun materiaalin ominaisuuksien ja hyvän puristussetin (muisti) välillä. Tuloksena on pehmeä, paikan päällä muotoutuva elastomeeri, joka soveltuu erinomaisesti "kuumien" elektronisten komponenttien kytkemiseen piirilevyyn kiinnitetyn viereisen metallikotelon tai lämmönsiirtimen kanssa. Ennen kovettumista se virtaa paineen alla kuin rasva. Kovettumisen jälkeen se ei pumppaannu rajapinnasta johtuen lämpösykleistä eikä ole kosketuskuiva.

Toisin kuin kovettuvat tilaa täyttävät materiaalit, nestemäinen menetelmä tarjoaa loputtomat paksuusvaihtoehdot vähäisellä tai olemattomalla rasituksella siirron ja kokoonpanon aikana. Se myös poistaa tarpeen tietyn paksuuden ja leikatun muodon erityisille tyynyille yksittäisissä sovelluksissa.

BERGQUIST GAP FILLER TGF 2000 on tarkoitettu käytettäväksi lämpöliitossovelluksissa, kun vahva rakenteellinen sidos ei ole tarpeen.

Vaihtoehdot ja kokoonpanot

Täytehelmet - Ei täytehelmiä, 0,007 tuuman täytehelmiä
Työaika - 15 minuuttia, 60 minuuttia, 600 minuuttia
Kartuusit - 50 cc, 400 cc
Paketit - 1200 cc, 10 gallonaa